

第六章

參考文獻

1. 軟板製程技術與應用全覽，亞洲智識，張靖霖。
2. M. K. Ghosh, K. L. Mittal, “Polimide Fundamentals and Application”, Maecel Dekker, New York, 1996.
3. 先進電子與面板構裝技術特刊，工業材料，214 期。
4. 高精密塗佈技術之極致應用 - 可撓式銅箔基板，工業材料，張麗敏，曾詩存，219 期，P.118。
5. 聚醯亞胺新型材料，科學出版社，丁孟賢，何天白。
6. 高密度印刷電路板技術(HDI Technology)，台灣電路板協會。
7. 電路板影像轉移技術(PCB Photo Imaging Technology)，台灣電路板協會。
8. 電路板會刊，第二十期，電鍍銅的過去現在與未來，白蓉生，P.6。
9. W. Volksen, *Advances in Polymer Science*, **117**, 112, 1993.
10. J. E. Mark, *Polym. Eng. Sci.*, **1996**, 8, 1667.
11. F. Hide; K. Nito; A. Yasuda, *Thin Solid Film*, **1994**, 240, 157.
12. Z. Ahmad; M. I. Sarwar; S. Wang; J. E. Mark, *Polymer*, **1997**, 38(17), 4523.
13. C. J. Cornelius; E. Marand, *Polymer*, **2002**, 43, 2385.
14. D. M. Delozier; R. A. Orwoll; J. F. Cahoon; N. J. Johnston; J. G. Smith; J. W. Connell, *Polymer*, **2002**, 43, 813.
15. L. Supriya; R. O. Claus, *Langmuir*. **2004**.
16. K. Akamatsu; S. Ikeda; H. Nawafune, *Langmuir*. **2003**, 19, 10366.
17. K. Akamatsu; S. Ikeda; H. Nawafune; S. Deki, *Chem. Mater.* **2003**, 15, 2488.
18. S. Ikeda; K. Akamatsu; H. Nawafune, *J. Mater. Chem.*, **2001**, 11, 2919.
19. S. Ikeda; K. Akamatsu; H. Nawafune, T. Nishino; S. Deki, *J. Phys. Chem. B*, **2004**.

20. K. Akamatsu; S. Ikeda; H. Nawafune; H. Yanagimoto, *J. AM. CHEM. SOC.*, **2004**, 126, 10822.
21. F. Faupel; R. Willecke; A. Thran, *Materials Science and Engineering*, **1998**, R22, 1.
22. A. Brenner; G. Riddell, *J. Res. Nat. Bur. Std.*, **1946**, 37, 31.
23. A. Brenner; G. Riddell, *J. Res. Nat. Bur. Std.*, **1947**, 39, 385.
24. T. Homma; A. Tamaki; H. Nakai; T. Osaka, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, **2003**, 559, 131.
25. T. C. Wang; B. Chen; M. F. Rubner; R. E. Cohen, *Langmuir*, **2001**, 17, 6610.
26. T. C. Wang; M. F. Rubner; R. E. Cohen, *Chem. Mater.*, **2003**, 15, 299.
27. R. R. Thomas, *Langmuir*, **1996**, 12, 5247.
28. L. E. Stephans; A. Myles; R. R. Thomas, *Langmuir*, **2000**, 16, 4706.
29. R. R. Thomas, *Langmuir*, **2003**, 19, 5763.
30. 機能膜鍍著及物性，復漢出版社，賴耿陽。
31. 無電解鍍金，復漢出版社，莊萬發。
32. Souheng Wu, "Polymer Interface and Adhesion", MARCEL DEKKER, INC., New York.
33. Adamson, A. W., *Physical Chemistry of Surface*, 5th ed.; Interscience Publishers; New York, 1990; Chapter X.
34. Hiemenz, P. C., *Principles of Colloid and surface Chemistry*, 2nd ed., Marcel Dekker; New York, 1986; Chapter 12.
35. Hui Pan; Binghai Liu; Jiabao Yi; Cheekok Poh; Sanhua Lim; Jun Ding; Yuanping Feng; C. H. A. Huan; Jianyi Lin, *J. Phys. Chem. B*, **2005**, 109, 3094-3098.
36. G. O. Mallory; V. A. Lloyd, *Plat. and Surf. Finish.*, 72 (8), **1985**, 64.
37. G. O. Mallory, *Plating*, 58, **1971**, 319.